

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2021-062

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记确认，苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 24 日、2021 年 6 月 16 日分别完成了 2021 年限制性股票激励计划及 2020 年度利润分配方案中送、转股份的登记工作。具体内容详见公司分别于 2021 年 5 月 26 日、2021 年 6 月 8 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州晶方半导体科技股份有限公司股权激励计划限制性股票授予结果公告》（公司编号：临 2021-052）、《晶方科技 2020 年年度权益分派实施公告》（公司编号：临 2021-053）。

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了江苏省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，相关登记信息如下：

注册号：913200007746765307

名称：苏州晶方半导体科技股份有限公司

法定代表人：王蔚

公司住所：苏州工业园区汀兰巷 29 号

注册资本：人民币 408,077,716 元

实收资本：人民币 408,077,716 元

公司类型：股份有限公司（外商投资、上市）

经营范围：许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产、制造、封装和测试集成电路产品，销售本公司所生产的产品并提供相关的服务。（依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2021年8月13日